

2024年6月24日

頼新政権が掲げる台湾の経済政策 ～「境内関外」「境外関内」の展望～

公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所 研修生 堀江 拓水

1. 頼新政権発足

2024年5月20日、民進党の頼清徳が台湾総統に就任し新政権が発足した。就任演説¹では、台湾の発展を推進するこれからの方向性にも言及し、「未来を見据えたスマート化と持続可能」、「航空宇宙産業の競争参入と海洋の探索」、「グローバルな布陣と、全世界でのマーケティング」と3つの柱を掲げ、半導体を中心とする台湾産業のさらなる発展推進を目指していくとした。



5月20日盛大に開催された
頼総統の就任式

また、郭智輝経済部長は5月30日就任後初めての会見を開き、経済分野における「境内関外」と「境外関内」という2つの大きなテーマ²を打ち出し、新政権の目指す方向性について言及した。

2. 経済部の打ち出した2つの方向性

(1) 境内関外

境内関外（台湾に世界の需要を呼び込む）については、台湾に海外からの投資や訪台客を呼び込む展望を明らかにした。台湾に世界の企業を呼び込み、また、国内の半導体やAI、次世代通信、ヘルスケアなどの産業を更に発展させることで、海外からの投資拡大を図ると同時に、ビジネス目的や観光目的の訪台客を拡大させることで、日本、韓国、シンガポール、ベトナムなど飛行機で3時間以内に行ける総人口4億人の需要を台湾に呼び込むというコンセプトだ。

海外企業の呼び込みには税制上の優遇措置を検討していることにも言及している。具体的な措置は発表されなかったが、既に財政部との意見交換が予定されている。

¹ 中華民國總統府 <https://www.president.gov.tw/News/28428>

² 經濟部

https://www.moea.gov.tw/Mns/populace/infographics/Infographics.aspx?menu_id=13724&info_id=32

3

(2) 境外関内

境外関内（台湾の供給を世界へ拡大）については、台湾の製造業団地を、世界に広げると言及した。特に、TSMC が熊本に2つの工場を設立したことと、日本側も九州に多くの半導体工場を設立していることを受けて、TSMC と関連サプライチェーンにワンストップサービスを提供する半導体サプライチェーンパークを九州に設立する計画であると説明した。現在熊本県には50ヘクタールの土地にTSMCが誘致されているが、計画中のサプライチェーンパークはその規模ではなく、さらに大きなものになると展望を語った。あくまで参考ではあるが、台湾の代表的なサイエンスパークである新竹サイエンスパーク³は686ヘクタールに600社以上の製造業者、16万人を超える従業員数を有し、年間平均売上高は4.8兆円を超えている。同規模のサイエンスパークが建設されればその経済波及効果は計り知れない。

3. 2つの方向性と福岡の関係

経済部の示した2つの方向性の双方で、特定の国に言及があったのは日本だけである。⁴とりわけ、福岡と台湾の関係強化は分野問わず著しい。今年4月には九州大学がTSMCと半導体人材育成強化を目的とする覚書⁵を締結した。久留米・広川新産業団地には半導体関連企業である家登精密工業が10,000平方メートル規模の用地を取得し24年中の着工を予定。金融分野では昨年の玉山銀行に続き、台新国際商業銀行や台湾最大手の台湾銀行も福岡に進出した。まさに「境外関内」の政策と方向性を同じくしている。

一方、日本国内の半導体分野において、九州のもつ役割は非常に大きい。九州の2023年の集積回路生産額⁶は1兆1533億円にのぼり、2007年以来、16年ぶりに1兆円を超えた。今年TSMCの出荷が開始されるため、生産額の過去最高更新も視野に入り、勢いは増すばかりだ。

新政権が発足して日は浅く、「境内関外・境外関内」政策の具体的な施策は今後明らかになっていく。引き続き「境内関外・境外関内」政策を注視していきたい。



九州のIC生産額の推移

(経済産業省 2023年九州地域の鉱工業動向 (速報))

※為替レート 1台湾元=4.82円

³新竹科学園区管理局 <https://www.sipa.gov.tw/index.jsp>

⁴【経長記者会 5-3】郭智輝抛「境外関内」將帶台廠赴日本九州設廠 「境内関外」擬祭優稅政策 <https://www.taisounds.com/news/content/76/128275>

⁵九州大学 <https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/notices/view/2668/>

⁶経済産業省 九州経済産業局 2023年九州地域の鉱工業動向 (速報) https://www.kyushu.meti.go.jp/keiki/chosa/iip_pdf/iip_2023cy.pdf